

第61期 第2四半期のご報告

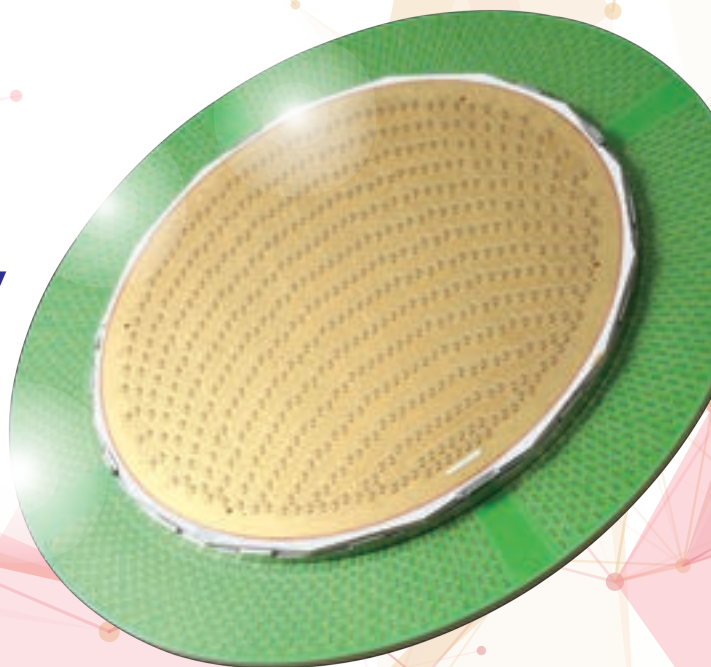
2019年4月1日～2019年9月30日

BUSINESS REPORT

JEM TODAY

JEM JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
日本電子材料株式会社

証券コード 6855



トップメッセージ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2019年度第2四半期連結累計期間(2019年4月1日～2019年9月30日)の事業の概況をご報告申し上げます。

事業の経過及び成果

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、次世代通信規格(5G)や人工知能(AI)、IoTの普及に牽引され、中長期的には緩やかな成長を予想する一方で、足元のデータセンターに関する投資への減速感等により、全体的にはメモリICを中心に在庫調整や半導体メーカーの設備投資計画の見直しが図られる等、調整局面が続きました。

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、一部では収益性の高い製品の拡販が進んだものの、全体としては本格的な需要回復には至らなかったことにより、前年同四半期を下回る結果となりました。利益面につきましても、原価低減を推し進めたものの、売上高の減少及びプロダクトミックスの影響や、Windows10への移行費用の発生並びに研究開発費の増加等により、前年同四半期を下回る結果となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は6,819百万円(前年同四半期比8.5%減)、営業利益は461百万円(前年同四半期比32.6%減)、経常利益は415百万円(前年同四半期比46.9%減)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、投資有価証券売却益による特別利益を計上したこと等により、375百万円(前年同四半期比51.8%減)となりました。

株主の皆様へ

半導体メーカーの設備投資の先送りや、海外経済の動向等、当社を取り巻く事業環境の先行きに対する不透明感は増しておりますが、中長期的には、次世代通信規格(5G)の普及等に牽引され、半導体市場、プローブカード市場ともに、緩やかに回復すると予想しております。

三田工場の建設工事につきましても、2020年1月の生産開始に向けた準備が、順調に進んでおります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



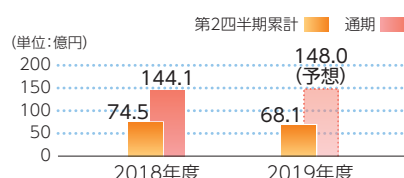
代表取締役社長

大久保 和正

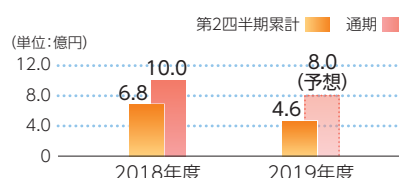
2019年12月

業績の推移

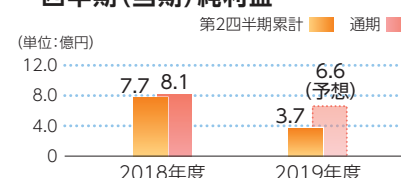
売上高



営業利益



親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



※記載金額未満は切り捨てて表示しております。

半導体の品質を支える。

スマートフォン、自動車、サーバー等多くの製品を支えている半導体。

当社グループは、半導体の品質を支える上で必要不可欠なプローブカードの開発、製造、販売を行っております。

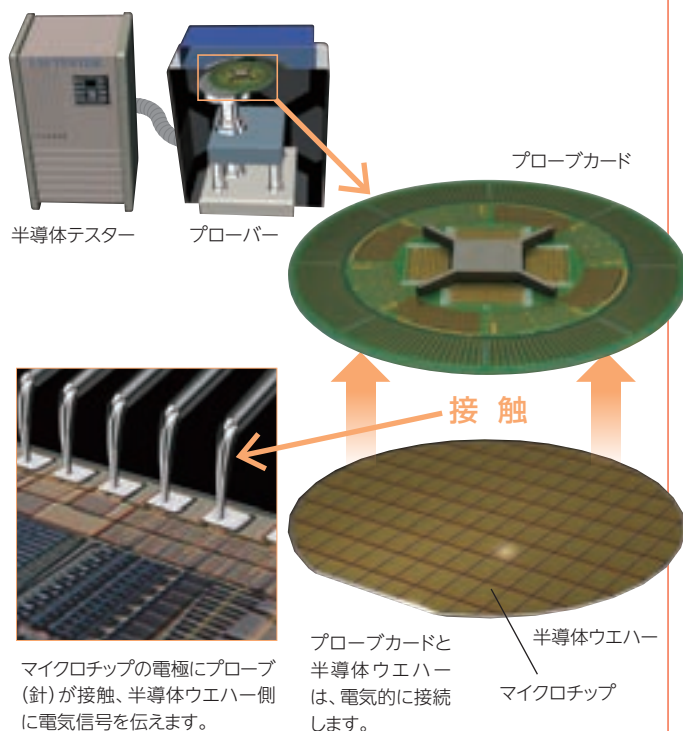
プローブカードの役割

プローブカードは、半導体の製造工程の中で、ウエハートテストとよばれる電気的な検査を行う工程で用いられます。

そして、半導体ウエハ上につくられたマイクロチップの電極に、最大10万本以上のプローブ(針)を接触させ、電気信号を半導体テスターに伝える重要な役割を担っております。

そのため、優れた電気的特性やミクロンオーダーの組立精度が求められます。

ウエハートテストのイメージ



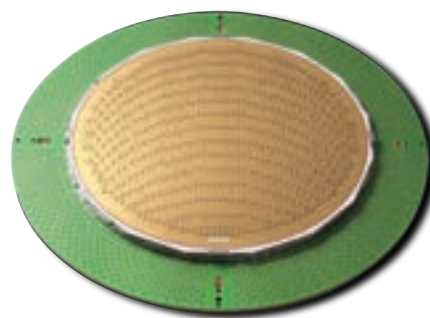
アドバンスドプローブカード(Mタイププローブカード)

半導体ウエハ上につくられたマイクロチップを同時に多数測定することに優れた当社の主力製品です。スマートフォンにも搭載されているDRAMやNAND型フラッシュメモリー等の検査に使われています。また、よりたくさんのプローブを搭載し高密度なプローブカードを生産するため、MタイププローブカードにはMEMSとよばれる高度な技術も用いられています。



MEMS製造(クリーンルーム)

Mタイププローブカード(MC)



技術の開発と製品化によって社会に貢献する。

半導体は、社会インフラを支えるIT基盤の中核技術として、また省エネルギーや環境に配慮した製品の基幹部品として、その重要性はますます高まっています。当社は、1970年に日本で最初にプローブカードの製造を開始し、長年エレクトロニクス産業の成長に貢献してまいりました。そしてこれからも、プローブカードを通じて半導体の品質を支えるとともに、技術の開発と製品化によって、社会に貢献する企業であり続けます。



世界の主要な生産・販売拠点

● 製造・販売拠点 ● 生産拠点



これまで、当社は先駆的に海外にも生産・販売拠点を設けてまいりました。近年、半導体市場はアジアを中心に成長しており、海外戦略の重要性が増しております。今後も当社グループは、海外拠点のネットワークを活かした販売活動の充実を図るとともに、日本から各国拠点への一層の技術支援により、海外販売の強化を推進いたします。

Topic

三田工場 2020年1月 生産開始

三田工場につきましては、2020年1月の生産開始に向けた準備が、順調に進んでおります。

三田工場は、今後のメモリーIC向けを中心としたMタイププローブカードの市場拡大や更なる製品の高度化を見据え、生産能力の強化を図るためのものです。

今後、三田工場が加わり、市場要求に対して一層迅速に対応することにより、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。



株式事項

(2019年9月30日現在)

発行可能株式総数	40,000,000株
発行済株式の総数	10,604,880株
株主数	5,818名

大株主

(2019年9月30日現在)

株主名	持株数	持株比率
(有) 大久保興産	1,266千株	11.96 %
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	661	6.24
大久保和正	495	4.68
日本マスタートラスト信託銀行(株)	488	4.61
大久保英正	399	3.77
(株) 三菱UFJ銀行	309	2.91
大久保昌男	290	2.73
古山陽一	260	2.45
日本電子材料社員持株会	195	1.84
野村信託銀行(株)	185	1.74

(注)持株比率は、自己株式(15,559株)を除いて計算しております。

役員

(2019年9月30日現在)

取締役		
代表取締役社長 社長執行役員 営業統括部長	大久保	和正
専務取締役 専務執行役員 管理部門統括部長	足立	安孝
取締役	井上	廣志*
取締役	中本	大介*
取締役 常勤監査等委員	竹原	克尚
取締役 監査等委員	濱田	幸和*
取締役 監査等委員	吉田	博之*

*は社外取締役

執行役員		
副社長執行役員 品質統括部長	呉	泰輝
常務執行役員 MEMS統括部長	坂田	輝久
上席執行役員 本社MEMS工場長	森	隆一郎
執行役員 生産統括部長	藤井	昭彦
執行役員 製品技術統括部長	澤井	守康

会社概要

社名	日本電子材料株式会社
英訳名	JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
住所	兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号 TEL.06-6482-2007 (代表)
設立	1960年4月6日
資本金	983,100千円
事業内容	●半導体検査用部品の開発・製造・販売 ●電子管部品の製造・販売
株式市場	東京証券取引所市場第一部
証券コード	6855

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基準日	定時株主総会 … 3月31日 剰余金の配当 … 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 ☎0120-094-777 (通話料無料) ホームページ https://www.tr.mufig.jp/daikou/
公告の方法	当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 http://www.jem-net.co.jp/

- (注) 1. 株主様の住所変更、買取請求、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等へお問合せ下さい。
2. 特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金に関するご照会などは三菱UFJ信託銀行にお問合せ下さい。